

北交所定期报告

2026年06月15日

证券分析师

赵昊
SAC: S1350524110004
zhaohao@huayuanstock.com
万泉
SAC: S1350524100001
wanxiao@huayuanstock.com

联系人

PPE 供应紧张叠加 AI、车电等需求攀升开启 PCB 景气周期，关注北交所相关标的

——北交所科技成长产业跟踪第七十九期（20260613）

投资要点：

- **上游中东 PPE 树脂面临断供风险，下游 AI、汽车电子等需求引领高端 PCB 景气周期。**据央视财经报道，2026 年 6 月 8 日，中东冲突带来的影响正从能源市场进一步蔓延到电子产品供应链。沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约 70% 的聚苯醚树脂（PPE）。如果高端 PPE 树脂供应出现问题，影响会波及到覆铜板层压板（CCL）、印制电路板（PCB）、服务器和终端电子设备等，高端 PPE 树脂的价值正在从工程塑料逻辑切换到 AI 高速互连材料逻辑。根据东山精密公告，2025 年，全球数据中心 PCB 市场为 181 亿美元，通信领域则为 102 亿美元，消费电子为 385 亿美元，汽车为 97 亿美元。在 AI 及工业智能化的支持下，到 2030 年，这四个细分市场预计将分别增长至 364 亿美元、136 亿美元、481 亿美元及 130 亿美元，相应的复合年增长率分别为 15.0%、6.0%、4.5%及 6.2%。根据财联社星矿数据不完全统计显示，2025 年 8 月至 2026 年 6 月 9 日，至少有 20 家 A 股 PCB 领域上市公司发布扩产公告，包含框架协议及意向性投资在内，涉及总投资金额超 800 亿元。目前 PCB 产业所进入的紧俏供需状态，是一场由 AI 服务器、智能汽车电子等品类引领的结构性景气周期。经过梳理，我们发现北交所 PCB 产业链核心标的共有 7 家，其中设备端包括锐翔智能、鸿仕达，PCB 制造端包括万源通、则成电子，上游材料端包括戈碧迦、天马新材，以及 PCBA 组装端的雅葆轩。
- **总量：北交所科技成长股股价涨跌幅中值-5.25%。**截至 2026 年 6 月 12 日，经梳理后本期锁定了 151 家核心标的池（持续更新）。从周度涨跌幅数据来看，2026 年 6 月 8 日至 6 月 12 日，北交所科技成长产业企业多数下跌，区间涨跌幅中值为-5.25%，其中上涨公司达 13 家（占比 9%），科力股份（+19.83%）、晟楠科技（+12.16%）、天宏锂电（+7.32%）、万通液压（+6.17%）、巨能股份（+6.11%）位列涨跌幅前五。北证 50、沪深 300、科创 50、创业板指周度涨跌幅分别为-4.35%、-0.82%、-0.31%、-3.22%。
- **行业：汽车市盈率 TTM 中值-4.81%至 22.6X。**2026 年 6 月 8 日至 6 月 12 日，北交所电子设备产业企业的市盈率 TTM 中值由 52.6X 降至 49.5X，市值中值由 18.1 亿元降至 17.0 亿元，晟楠科技（+12.16%）、奥迪威（+1.19%）、铁大科技（-0.19%）分列市值涨跌幅前三甲。北交所机械设备产业企业的市盈率 TTM 中值由 37.3X 降至 34.9X，市值中值由 15.9 亿元降至 15.4 亿元，科力股份（+19.83%）、万通液压（+6.17%）、巨能股份（+6.11%）分列市值涨跌幅前三甲。北交所信息技术产业企业的市盈率 TTM 中值由 56.2X 降至 52.5X，市值中值由 20.3 亿元降至 18.7 亿元，星图测控（+4.00%）、云星宇（-0.55%）、汉鑫科技（-2.93%）分列市值涨跌幅前三甲。北交所汽车产业企业的市盈率 TTM 中值由 23.7X 降至 22.6X，市值中值由 14.9 亿元降至 14.6 亿元，邦德股份（+2.60%）、同力股份（+1.01%）、建邦科技（+0.30%）分列市值涨跌幅前三甲。北交所新能源产业企业的市盈率 TTM 中值由 39.5X 降至 37.2X，市值中值由 19.1 亿元降至 18.1 亿元，天宏锂电（+7.32%）、德瑞锂电（-2.14%）、力王股份（-2.52%）分列市值涨跌幅前三甲。
- **公告：骏创科技拟与合作方共同出资设立苏州巴斯巴新能源技术有限公司。**骏创科技：为完善公司产品结构，实现公司向母线排产品的供应链纵向延伸，提高产品附加值，提升在储能/动力电池、新能源汽车零部件领域的综合竞争力，苏州骏创汽车科技股份有限公司与上海勤坤模具科技有限公司签署了《合资协议》，拟共同出资设立合资公司苏州巴斯巴新能源技术有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准）。
- **风险提示：宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、资料统计误差风险**

内容目录

1. 上游中东 PPE 树脂面临断供风险，下游 AI、汽车电子等需求引领高端 PCB 景气周期	5
1.1. 新闻：中东战火再起，供应全球 70%PPE 树脂基地或断供	5
1.2. 行业：预计 2025-2030 年全球数据中心 PCB 市场规模 CAGR 将达 15%	6
2. 总量：北交所科技成长股股价涨跌幅中值-5.25%	11
3. 行业：汽车市盈率 TTM 中值-4.81%至 22.6X	12
4. 公告：骏创科技拟与合作方共同出资设立苏州巴斯巴新能源技术有限公司	17
5. 风险提示	17

图表目录

图表 1: 覆铜板产业链	5
图表 2: 电子树脂的种类和特征	6
图表 3: 印制电路板通常可分为单面板、双面板和多层板	6
图表 4: 印制电路板(PCB)行业产业价值链	7
图表 5: 预计 2025-2030 年全球数据中心 PCB 市场规模 CAGR 将达 15% (单位: 十亿美元)	7
图表 6: 预计 2025-2030 年全球单层及多层 PCB 市场规模 CAGR 将达 7% (单位: 十亿美元)	8
图表 7: 预计 2025-2030 年全球软板市场规模 CAGR 将达 3.8% (单位: 十亿美元) ..	8
图表 8: 我国 PCB 产业市场集中度较低, CR5 为 33.9% (2024 年数据)	9
图表 9: 2025 年 8 月以来 PCB 产业链扩产/融资公告总览表	9
图表 10: 北交所 PCB 产业链核心标的共有 7 家 (20260612 数据)	10
图表 11: 北交所科技成长产业企业区间涨跌幅中值为-5.25%	11
图表 12: 科力股份、晟楠科技、天宏锂电等涨幅居前	11
图表 13: 北交所电子设备产业 PETTM 中值降至 49.5X	12
图表 14: 50~100X 区间内的企业数量保持 12 家 (家)	12
图表 15: 北交所电子设备产业总市值降至 1082 亿元 (家)	12
图表 16: 晟楠科技、奥迪威等市值涨跌幅居前	12
图表 17: 北交所机械设备产业 PETTM 中值降至 34.9X	13
图表 18: 50~100X 区间内的企业增至 8 家 (家)	13
图表 19: 北交所机械设备产业总市值降至 923 亿元 (家)	13
图表 20: 科力股份、万通液压等市值涨跌幅居前	13
图表 21: 北交所信息技术产业 PETTM 中值降至 52.5X	14
图表 22: >100X 区间内的企业数量保持 9 家 (家)	14
图表 23: 北交所信息技术产业总市值降至 654 亿元 (家)	14
图表 24: 星图测控、云星宇等市值涨跌幅居前	14
图表 25: 北交所汽车产业 PETTM 中值降至 22.6X	15
图表 26: 0~20X 区间内的企业数量保持 6 家 (家)	15
图表 27: 北交所汽车产业总市值降至 410 亿元 (家)	15

图表 28: 邦德股份、同力股份等市值涨跌幅居前	15
图表 29: 北交所新能源产业 PETTM 中值降至 37.2X	16
图表 30: 20~30X 区间内的企业数量增至 4 家 (家)	16
图表 31: 北交所新能源产业总市值降至 441 亿元 (家)	16
图表 32: 天宏锂电、德瑞锂电等市值涨跌幅居前	16
图表 33: 骏创科技拟与合作方共同出资设立苏州巴斯巴新能源技术有限公司	17

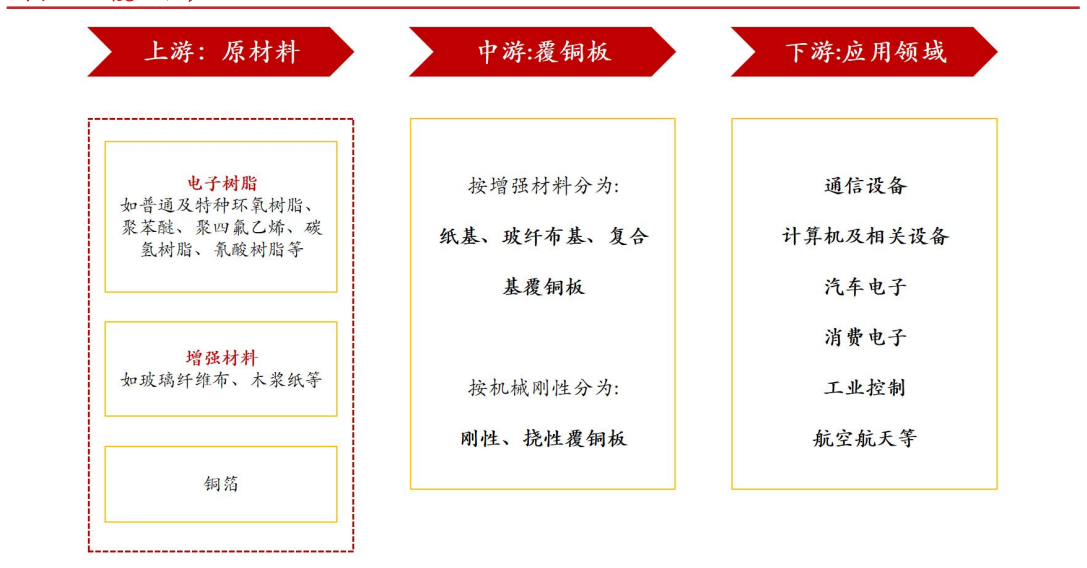
1. 上游中东 PPE 树脂面临断供风险，下游 AI、汽车电子等需求引领高端 PCB 景气周期

1.1. 新闻：中东战火再起，供应全球 70%PPE 树脂基地或断供

据央视财经报道，2026 年 6 月 8 日，中东冲突带来的影响正从能源市场进一步蔓延到电子产品供应链。沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约 70%的聚苯醚树脂（PPE）。如果高端 PPE 树脂供应出现问题，影响会波及到覆铜板层压板（CCL）、印制电路板（PCB）、服务器和终端电子设备等，高端 PPE 树脂的价值正在从工程塑料逻辑切换到 AI 高速互连材料逻辑。PPE 不属于蚀刻液、电镀液和阻焊油墨，也不是半导体前道材料，它属于 PCB 基材中的树脂体系。

根据中国化信，覆铜板产业链上游原材料包括电子树脂、增强材料、铜箔等。铜箔作为导电层的主要材料，其厚度和纯度决定了覆铜板的电气性能。电子树脂作为粘合剂，将增强材料和铜箔紧密结合，并提供电气绝缘性能。产业链中游环节是覆铜板的生产制造过程，包括原材料的加工、层压、固化等工艺。覆铜板按机械刚性可分为刚性覆铜板和挠性覆铜板，按照增强材料可分为玻璃纤维布基覆铜板、纸基覆铜板和复合基覆铜板。玻璃纤维布基覆铜板具有优异的机械强度和电气性能，是最常用的覆铜板类型；纸基覆铜板成本较低，但机械强度和电气性能相对较差，通常用于低端电子产品；复合基覆铜板结合了多种增强材料，如玻璃纤维和纸，以平衡成本和性能。覆铜板的下游直接应用于 PCB 的生产制造，通过蚀刻、钻孔、层压等工艺形成电路图案，并与电子元器件进行表面贴装，最终组装成各类电子设备。PCB 在现代电子设备中扮演着核心角色，提供支撑、连接元件、信号传输、散热管理等功能，终端应用包括通信设备、汽车电子、计算机及相关设备、消费电子、工业控制、航空航天等众多领域。未来，随着新一代信息技术的不断突破，PCB 行业或朝着微型化、轻便化、多功能化和高速高频化等方向发展。高密度互连（HDI）技术的应用越来越广泛，能在更小的空间内实现更多连接点，提高电路整体性能和效率。

图表 1：覆铜板产业链



资料来源：中国化信、华源证券研究所

根据中国化信，在 4G 通信时代，基站主要采用环氧树脂玻璃布基覆铜板（简称 FR-4 覆铜板），其树脂体系主要围绕低溴环氧树脂、高溴环氧树脂、异氰酸酯改性环氧树脂和酚醛环氧树脂等类型构建。进入 5G 时代，由于信号频率更高且数据传输量大，FR-4 材料在介电性能等方面已难以满足 5G 基站的高频高速要求。**聚四氟乙烯（PTFE）、碳氢树脂和聚苯醚（PPE）**等电子树脂基材，因其具有更低的介质损耗特性，能够更好地满足 5G 通信、AI 服务器、高速交换机、数据中心及自动驾驶等领域对覆铜板性能的苛刻要求。

图表 2：电子树脂的种类和特征

应用领域	树脂种类	介质损耗因子 Df (1GHz)	传输损耗 (dB·m ⁻¹)	传输速率 (Gbps)
常规电路基材	环氧树脂	>0.02	-	<5
常规电路基材	环氧树脂	0.01-0.02	-	5
中等损耗、高速电路基材	改性环氧树脂	0.008-0.01	-35	10
中等损耗、高速电路基材	改性环氧树脂	0.005-0.008	-25	25
微波/毫米波、高频电路基材	PTFE、碳氢树脂、PPE 树脂	0.002-0.005	-10~-16	56
微波/毫米波、高频电路基材	PTFE、碳氢树脂、PPE 树脂	<0.002	-10~-16	56

资料来源：中国化信、华源证券研究所

1.2. 行业:预计 2025-2030 年全球数据中心 PCB 市场规模 CAGR 将达 15%

根据万源通招股书，印制电路板根据导电图形层数、基材种类、基材结构、下游行业或技术工艺等标准有着多种不同的分类方式。按线路板层数划分，印制电路板通常可分为单面板、双面板和多层板。

图表 3：印制电路板通常可分为单面板、双面板和多层板

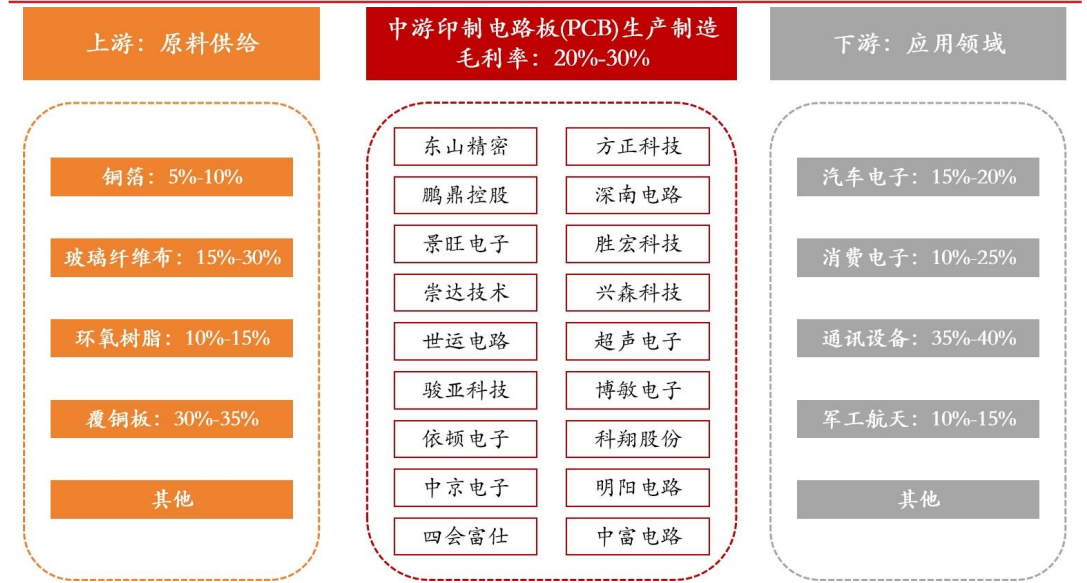
产品种类	产品特性	主要应用领域
单面板	在绝缘基板单面覆铜，在铜层上采用影像转移方法制作出导线图层及需要焊接的焊盘，其特点是图形制作工艺快捷、产品制作周期短、制作成本低、产品品质稳定性高。	普通家用电器、工控电源、快充电源、汽车车灯等简单的电子产品。
双面板	在绝缘基板上两面布线路结构式的电路板，经由导通孔将两面线路连接。与单面板相比，双面板的应用与单面板基本相同，主要特点是增加了单位面积的布线密度，其结构比单面板复杂，制作工艺流程增加。	消费电子、汽车电子、通信设备、工业控制等领域。
多层板	PCB 多层板与单面板、双面板最大的不同就是增加了内部电源层和接地层，用一块双面作内层、两块单面作外层或多块双面作内层、两块单面作外层的印刷线路板，通过定位系统及绝缘材料交替叠合在一起且导电图形按设计要求进行互连的印刷线路板就成为四层、六层及以上印刷电路板，也称为多层印刷线路板。电源和地线网络主要在电源层上布线。多层板布线主要还是以顶层和底层为主，以中间布线层为辅。多层板的设计与双面板的设计方法基本相同，其关键在于如何优化内层层的布线，使电路板的布线更合理，电磁兼容性更好。多层板层数越多，技术层次也越高，对产品的技术支持能力也越强。	消费电子、电池管理系统、服务器、汽车电子、储能、5G 通讯、医疗器械等领域。

资料来源：万源通招股书、华源证券研究所

根据智研咨询，上游覆铜板毛利率较高，产品毛利率在 30%-35% 左右；中游印制电路板（PCB）制造的毛利率约为 20%-30%；下游应用领域各行业毛利率水平差距较大，其中

通信设备行业毛利率较高，整体在 35%–40%左右；汽车电子行业毛利率约 15%–20%；消费电子行业毛利率约 10%–25%；军工航天行业毛利率约 10%–15%。

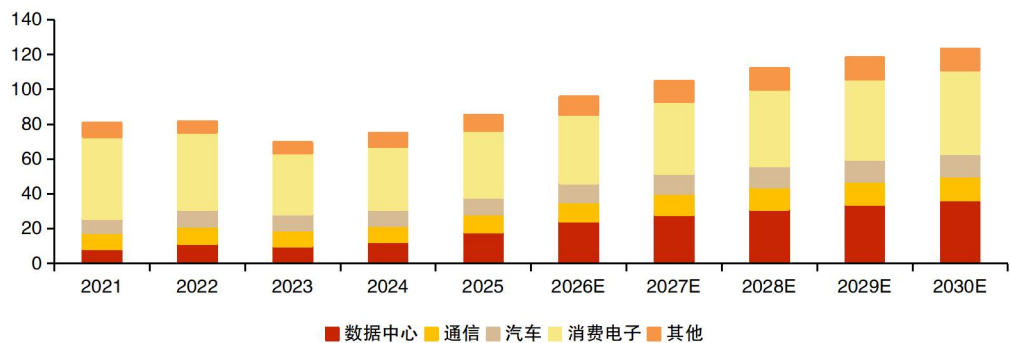
图表 4：印制电路板(PCB)行业产业价值链



资料来源：智研咨询、华源证券研究所

根据东山精密公告等，2025 年，全球数据中心 PCB 市场为 181 亿美元，通信领域则为 102 亿美元，消费电子为 385 亿美元，汽车为 97 亿美元。在 AI 及工业智能化的支持下，到 2030 年，这四个细分市场预计将分别增长至 364 亿美元、136 亿美元、481 亿美元及 130 亿美元，相应的 2025–2030 年复合年增长率分别为 15.0%、6.0%、4.5%及 6.2%。由于消费者及数据中心需求疲软、宏观经济面临逆风挑战及云投资保守降低了整体 PCB 需求，全球 PCB 市场从 2022 年的 817 亿美元下降至 2023 年的 695 亿美元，而供需失衡则加剧了行业价格竞争。

图表 5：预计 2025–2030 年全球数据中心 PCB 市场规模 CAGR 将达 15%（单位：十亿美元）

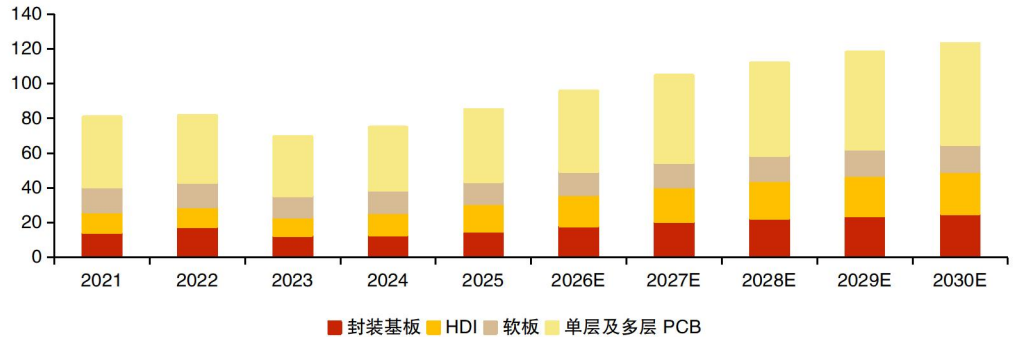


资料来源：Prismark、灼识咨询、东山精密公告、华源证券研究所
注：其他领域主要包括工控系统、医疗器械等

根据东山精密公告等，PCB 可分为单层及多层 PCB、HDI、软板及封装基板。就销售收入而言，2025 年，全球单层及多层 PCB 市场规模为 416 亿美元、HDI 则为 158 亿美元、软板为 129 亿美元、封装基板为 149 亿美元。到 2030 年，全球单层及多层 PCB、HDI PCB、

软板及封装基板的市场规模预计将分别达到 583 亿美元、245 亿美元、155 亿美元及 250 亿美元，其中 2025 年至 2030 年的相应复合年增长率分别为 7.0%、9.2%、3.8%及 10.9%。

图表 6：预计 2025-2030 年全球单层及多层 PCB 市场规模 CAGR 将达 7%（单位：十亿美元）

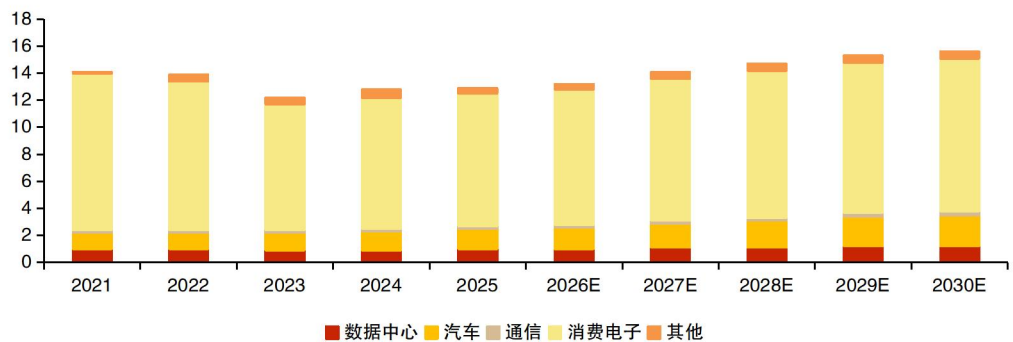


资料来源：Prismark、灼识咨询、东山精密公告、华源证券研究所

注：软硬结合板的市场规模被纳入软板的市场规模，主要乃由于二者对柔性基板的核心依赖以及与软板在制造过程中的大量重叠，使其在技术及结构上与软板类别相关联。

根据东山精密公告等，在消费电子领域，软板是实现智能手机、平板电脑及可穿戴设备内部显示模组、摄像头、生物识别等模组间高速信号传输的主流方案；在汽车电子领域，软板广泛应用于汽车电池管理系统（BMS）以及车载显示。在工业控制领域，软板凭借其在复杂环境下的高可靠性和空间适应性，使得工业设备实现稳定高效的连接。随着边缘 AI 设备在更小巧的设计中集成更多功能，能够实现三维布线和高密度互连的软板，在高端化与定制化趋势的推动下需求或将持续增长，成为边缘侧 PCB 产业价值提升的关键驱动力。从下游市场规模来看，全球软板市场呈现稳步增长态势，市场规模于 2025 年达到 129 亿美元，预计 2030 年将增长至 155 亿美元，复合年增长率为 3.8%。2026 年至 2030 年，消费电子市场或受益于智能手机、AR/VR 设备、可穿戴设备等智能设备出货量增长，驱动软板市场规模增长。另一方面，汽车电子是全球软板行业中增长最快的应用领域。

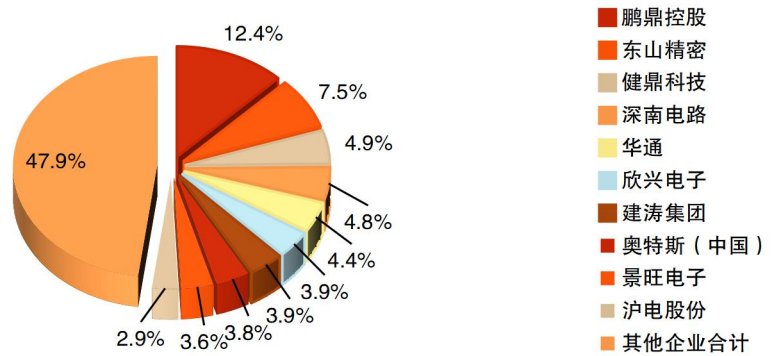
图表 7：预计 2025-2030 年全球软板市场规模 CAGR 将达 3.8%（单位：十亿美元）



资料来源：Prismark、灼识咨询、东山精密公告、华源证券研究所 注：其他领域主要包括工控系统、医疗器械等

根据中商产业研究院，由于我国 PCB 产业主要集中在中低端制造领域，高性能制造领域较少，制造门槛不高，市场集中度较低，2024 年 CR5 为 33.9%，鹏鼎控股市场份额占比最多，达 12.4%。东山精密、健鼎科技、深南电路、华通分别占比达 7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。

图表 8：我国 PCB 产业市场集中度较低，CR5 为 33.9%（2024 年数据）



资料来源：CPCA、中商产业研究院、华源证券研究所

根据财联社星矿数据不完全统计显示，2025 年 8 月至 2026 年 6 月 9 日，至少有 20 家 A 股 PCB 领域上市公司发布扩产公告，包含框架协议及意向性投资在内，涉及总投资金额超 800 亿元。目前 PCB 产业所进入的紧俏供需状态，是一场由 AI 服务器、智能汽车电子等品类引领的结构性景气周期。整体来看，目前产业面临的主要卡点，一方面在于高端产能（并非中低端产能）供不应求，“甚至 3-5 年内都会处于高景气状态而非产能过剩”；另一方面，原材料涨价为产业链带来的价格压力和产能制约，迫使下游、中游企业纷纷向更上游环节布局。再次，终端 AI 服务器推动 PCB 产业在技术、材料、性能、良率等方面不断迭代，向整条产业链传导，各家企业纷纷从根本层面“提质增效”。

图表 9：2025 年 8 月以来 PCB 产业链扩产/融资公告总览表

序号	所属环节	公司名称	公告日期	投资/募资金额 (亿元)	核心投向
1	PCB 板制造	胜宏科技	2026/3/13	≤200	年度规划投资额，用于 AI 服务器、高性能计算用高阶 PCB 产能扩建与产线升级
2		沪电股份	2026/4/1	≈68	高速运算服务器、下一代高速网络交换机用 PCB
3		沪电股份	2026/3/6	≈55	超高层、高频高速 PCB，分三期建设，达产后年新增产值约 65 亿
4		沪电股份	2026/2/12	≈33	高层数、高频高速、高密度互联、高流通 PCB，年新增 14 万 m ² 产能
5		鹏鼎控股	2026/3/17	110	淮安高端 PCB 基地，高阶 HDI (含 SLP)、HLC 等，服务 AI “云—管—端” 全产业链
6		鹏鼎控股	2026/5/25	1.43	竞得深圳宝安地块，为未来 PCB 产业投资储备发展空间
7		深南电路	2026/4/23	≤46	无锡高速高密、高多层电子电路项目，建设周期约 12 个月
8		景旺电子	2025/8/24	50	珠海金湾基地：高多层技改+新建 HDI 工厂 (32 亿，年产 80 万 m ²) + 关键工序强化
9		景旺电子	2026/3/28	≤7	追加泰国生产基地投资额
10		奥士康	2026/2/1	18.2 (拟募 ≤10)	年产 84 万 m ² 高层板及 HDI 板
11		四会富仕	2026/4/8	≤9.5	年产 60 万 m ² 高多层、HDI 电路板 (一期)
12		中富电路	2026/5/29	≤8.5	鹤山 AI 用 PCB 产线改扩建 (6 亿) + 数字化升级 (0.8 亿) + 补流 (1.7 亿)
13		满坤科技	2025/10/15	≤7.6	泰国高端 PCB 生产基地 (4.7 亿) + 智能化与数字化升级 (2.9 亿)
14		强达电路	2026/3/25	≤5.5	南通年产 96 万 m ² 多层板、HDI 板项目
15		科翔股份	2026/2/5	2.87	智慧电子高端服务器用 PCB 产线升级 (2.4 亿) + 补流 (0.47 亿)
1	上游材料	生益科技	2026/4/25	≈52	高性能覆铜板 (基材 4800 万 m ² /年 + 粘结片 1 亿米/年)，一期约 30 亿
2		生益科技	2026/1/4	≈45 (意向)	松山湖第二工厂高性能覆铜板项目
3		德福科技	2026/5/27	≈31	年产 5 万吨高端 AI 电子铜箔 (分两期各 2.5 万吨)
4		中国巨石	2026/5/13	≈44.31	年产 5 万吨电子纱 3.2 亿米电子布生产线

5		聚杰微纤	2026/5/8	≤11	高端电子布建设项目，总投资 12.32 亿，服务 AI 服务器、高频通信等
6		铜冠铜箔	2026/2/2	持续扩产	持续扩产，HVL P 极低轮廓铜箔全流程生产线已建成，持续推进产能扩充
1		鼎泰高科	2026/3/25	50	东莞厚街智能制造总部基地，聚焦微型钻针、高端工业刀具等
2	专用刀具及 耗材	欧科亿	2026/2/11	≤7	收购慧联电子 70% 股权，切入 PCB 刀具（年产 2 亿支 PCB 工具）
3		欧科亿	2026/5/19	≤4.25	收购永鑫精工 51% 股权，获取年产 3.5 亿支 PCB 微钻+1 亿支铣刀产能
4		中钨高新	2026/5/16	1.825	新增高端微型精密刀具 1.5 亿支/年产能
5		中钨高新	2026/2/10	1.45	新增 PCB 钻针棒 3000 万支/年产能
1	设备制造	沪电股份	2026/2/13	—	常州金坛全资子公司，搭建 CoWoP 等前沿技术与 mSAP 先进工艺孵化平台
合计涉及公司数：20 家					披露投资/募资总额：超 800 亿元（含框架协议及意向性投资）

资料来源：财联社星矿数据、华源证券研究所 注：统计口径为 2025 年 8 月至今，存在不完整的可能性

经过梳理，我们发现北交所 PCB 产业链核心标的共有 7 家，其中设备端包括锐翔智能、鸿仕达，PCB 制造端包括万源通、则成电子，上游材料端包括戈碧迦、天马新材，以及 PCBA 组装端的雅葆轩。

图表 10：北交所 PCB 产业链核心标的共有 7 家（20260612 数据）

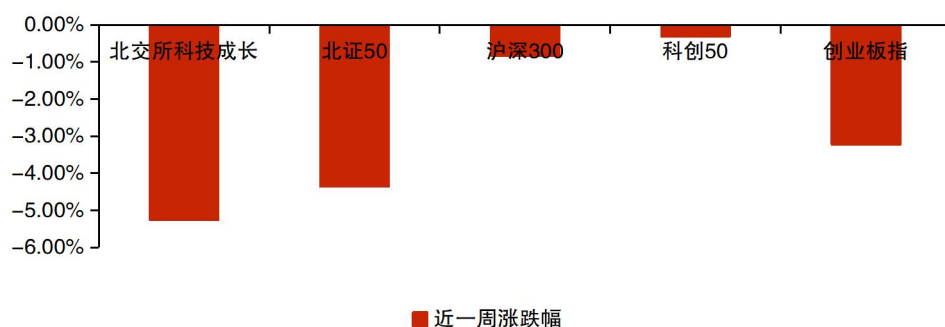
证券代码	证券简称	产业链定位	业务	市值/亿元	市盈率	2025 年 营收/亿 元	2025 年归 母净利润/ 万元
920438.BJ	戈碧迦	上游电子玻纤原料	光学玻璃和高端水晶工艺玻璃	113.49	351.12	5.52	2,958.48
920125.BJ	鸿仕达	PCB 后端设备	FPC/PCB 贴装设备等	96.04	132.20	6.64	6,975.14
920178.BJ	锐翔智能	PCB 上游设备	FPC 干制程智能制造装备	68.79	52.64	5.98	13,067.78
920060.BJ	万源通	刚性 PCB 制造	单面板、双面板、多层板和金属基板等	44.35	38.65	11.80	12,471.44
920971.BJ	天马新材	上游基础材料层	α-氧化铝、氢氧化铝和高纯纳米氧化铝	35.58	83.78	2.74	3,816.42
920821.BJ	则成电子	FPC+高速 PCB	FPC 组件产品	29.17	369.92	3.94	1,524.50
920357.BJ	雅葆轩	PCBA 组装	电子产品线路板 SMT 批量嵌入式加工服务	20.00	26.84	5.99	6,583.11

资料来源：Wind、华源证券研究所

2. 总量：北交所科技成长股股价涨跌幅中值-5.25%

截至 2026 年 6 月 12 日，经梳理后本期锁定了 151 家核心标的池（持续更新）。从周度涨跌幅数据来看，2026 年 6 月 8 日至 6 月 12 日，北交所科技成长产业企业多数下跌，区间涨跌幅中值为-5.25%，其中上涨公司达 13 家（占比 9%），科力股份（+19.83%）、晟楠科技（+12.16%）、天宏锂电（+7.32%）、万通液压（+6.17%）、巨能股份（+6.11%）位列涨跌幅前五。北证 50、沪深 300、科创 50、创业板指周度涨跌幅分别为-4.35%、-0.82%、-0.31%、-3.22%。

图表 11：北交所科技成长产业企业区间涨跌幅中值为-5.25%



资料来源：iFinD、华源证券研究所 注：数据截至 2026 年 6 月 12 日，新上市公司并入统计，下同

本周（2026 年 6 月 8 日至 6 月 12 日，下同），前十大涨跌幅标的分别是科力股份、晟楠科技、天宏锂电、万通液压、巨能股份、机科股份、星图测控、七丰精工、邦德股份、美心翼申。

图表 12：科力股份、晟楠科技、天宏锂电等涨幅居前

证券代码	证券简称	市值涨跌幅	市值/亿元	市盈率 TTM	2025 年营收/亿元	2025 年归母净利润/万元	业务
920088.BJ	科力股份	19.83%	40.50	87.12	4.46	5,657.09	油田技术服务、油田专用化学品和油田专用设备
920006.BJ	晟楠科技	12.16%	17.15	721.67	1.12	794.98	航空装备制造、军用电源领域相关产品
920252.BJ	天宏锂电	7.32%	22.58	269.28	3.99	908.34	锂电池模组
920839.BJ	万通液压	6.17%	35.20	29.92	6.96	12,553.24	液压产品
920578.BJ	巨能股份	6.11%	14.20	-282.50	1.65	-214.63	以实现智能工厂为目标的各类工业机器人、自动化生产线和智能工厂管理软件
920579.BJ	机科股份	5.67%	23.15	-41.61	4.73	-3,803.88	智能制造装备及整体解决方案
920116.BJ	星图测控	4.00%	147.23	144.98	3.21	10,083.16	航天测控管理、航天数字仿真、太空态势感知、卫星在轨服务
920169.BJ	七丰精工	3.15%	20.67	74.41	2.08	2,886.60	紧固件产品
920271.BJ	邦德股份	2.60%	14.99	17.17	3.80	10,007.95	热交换器相关产品
920833.BJ	美心翼申	1.54%	11.95	55.15	4.38	2,891.78	精密机械零部件

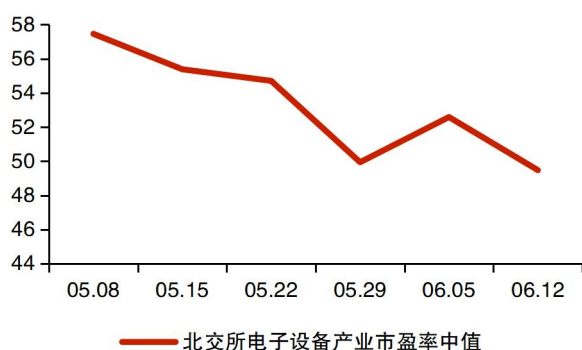
资料来源：iFinD、华源证券研究所 注：数据截至 20260612；涨跌幅区间为 2026 年 6 月 8 日至 6 月 12 日

3. 行业：汽车市盈率 TTM 中值-4.81%至 22.6X

➤ 电子设备（46家）：市盈率 TTM 中值由 52.6X 降至 49.5X

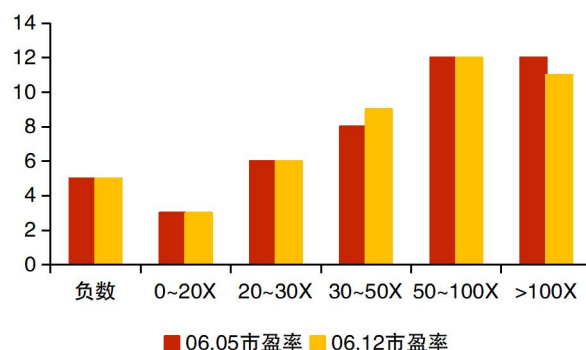
本周，从估值表现看，北交所电子设备产业企业的市盈率 TTM 中值由 52.6X 降至 49.5X。从分布区间来看，位于 30~50X 区间内的企业数量增至 9 家；位于 >100X 区间内的企业数量减至 11 家；位于其他区间内的企业数量不变。（注：晟楠科技、成电光信、富士达、星辰科技属于电子设备产业国防军工子行业分类）

图表 13：北交所电子设备产业 PETTM 中值降至 49.5X



资料来源：iFinD、华源证券研究所

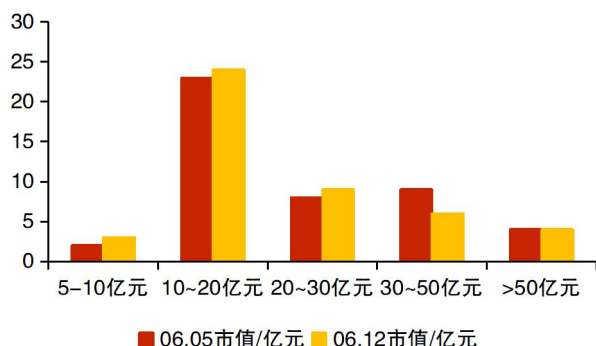
图表 14：50~100X 区间内的企业数量保持 12 家（家）



资料来源：iFinD、华源证券研究所

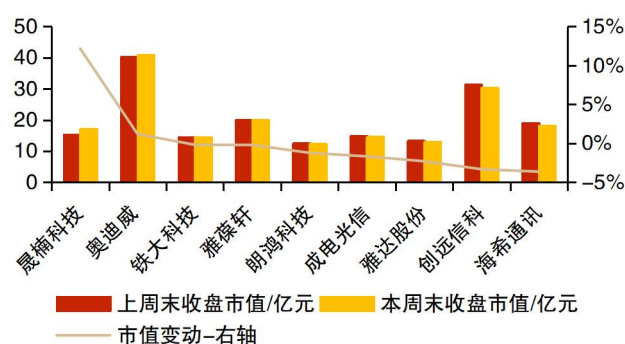
本周北交所电子设备产业企业的市值整体有所下降，总市值由 1181.3 亿元降至 1081.9 亿元，市值中值由 18.1 亿元降至 17.05 亿元。从分布区间来看，位于 5~10 亿元市值区间内的企业数量增加；位于 10~20 亿元市值区间内的企业数量增加；位于 20~30 亿元市值区间的企业数量增加；位于 30~50 亿元市值区间的企业数量减少；位于 >50 亿元市值区间的企业数量不变。从本周个股市值表现来看，晟楠科技（+12.16%）、奥迪威（+1.19%）、铁大科技（-0.19%）分列市值涨跌幅前三甲。

图表 15：北交所电子设备产业总市值降至 1082 亿元(家)



资料来源：iFinD、华源证券研究所

图表 16：晟楠科技、奥迪威等市值涨跌幅居前

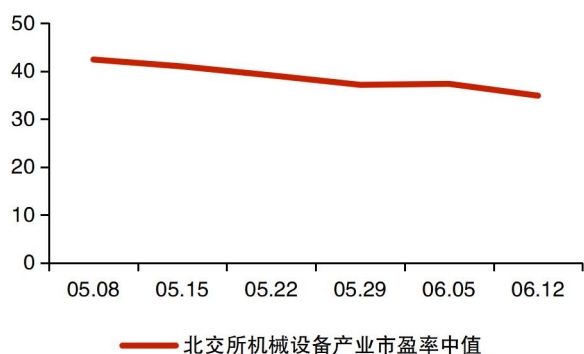


资料来源：iFinD、华源证券研究所

➤ 机械设备（41家）：市盈率 TTM 中值由 37.3X 降至 34.9X

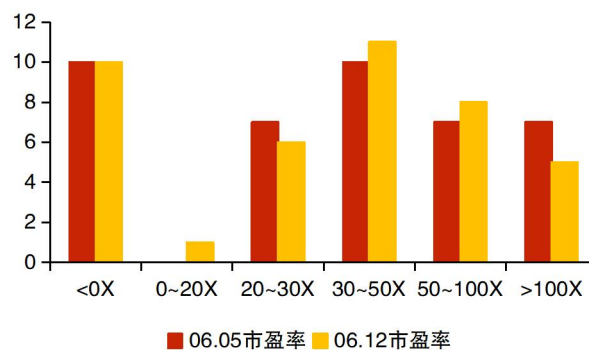
本周，从估值表现看，北交所机械设备产业企业的市盈率 TTM 中值由 37.3X 降至 34.9X。从分布区间来看，位于<0X 区间内的企业数量不变；位于 0~20X 区间内的企业数量增至 1 家；位于 20~30X 区间内的企业数量减至 6 家；位于 30~50X 区间内的企业数量增至 11 家；位于 50~100X 区间内的企业数量增至 8 家；位于>100X 区间内的企业数量减至 5 家。

图表 17：北交所机械设备产业 PETTM 中值降至 34.9X



资料来源：iFinD、华源证券研究所

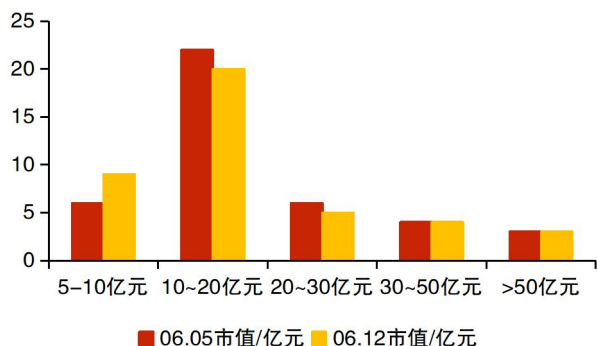
图表 18：50~100X 区间内的企业增至 8 家（家）



资料来源：iFinD、华源证券研究所

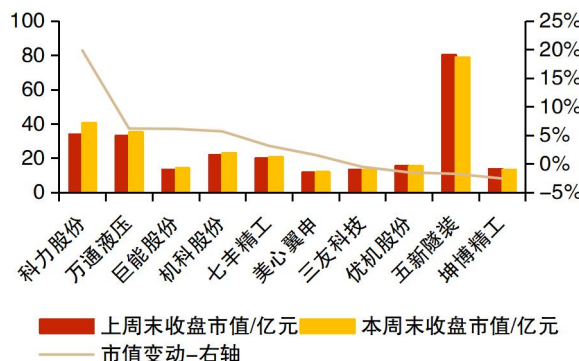
本周北交所机械设备产业企业的市值整体有所下降，总市值由 949.5 亿元降至 922.6 亿元，市值中值由 15.9 亿元降至 15.4 亿元。从分布区间来看，位于 5~10 亿元市值区间内的企业数量增加；位于 10~20 亿元市值区间的企业数量减少；位于 20~30 亿元市值区间的企业数量减少；位于其他市值区间的企业数量不变。从本周个股市值表现来看，科力股份（+19.83%）、万通液压（+6.17%）、巨能股份（+6.11%）分列市值涨跌幅前三甲。

图表 19：北交所机械设备产业总市值降至 923 亿元（家）



资料来源：iFinD、华源证券研究所

图表 20：科力股份、万通液压等市值涨跌幅居前

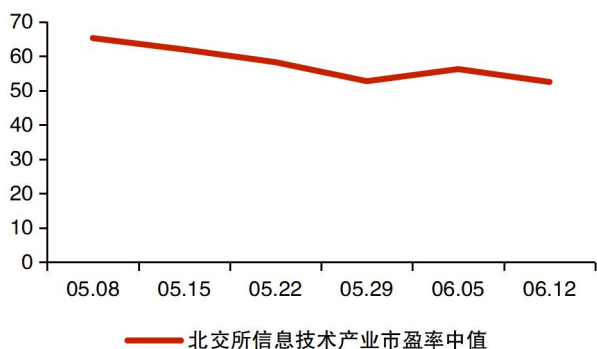


资料来源：iFinD、华源证券研究所

➤ 信息技术（23家）：市盈率 TTM 中值由 56.2X 降至 52.5X

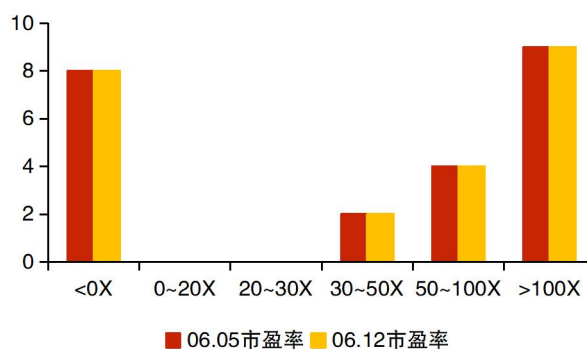
本周,从估值表现看,北交所信息技术产业企业的市盈率 TTM 中值由 56.2X 降至 52.5X。从分布区间来看,位于所有区间内的企业数量不变。

图表 21: 北交所信息技术产业 PETTM 中值降至 52.5X



资料来源: iFinD、华源证券研究所

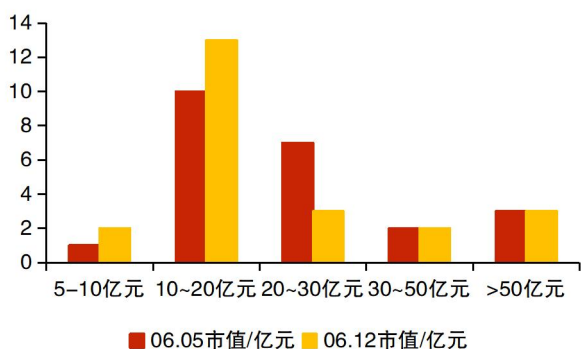
图表 22: >100X 区间内的企业数量保持 9 家 (家)



资料来源: iFinD、华源证券研究所

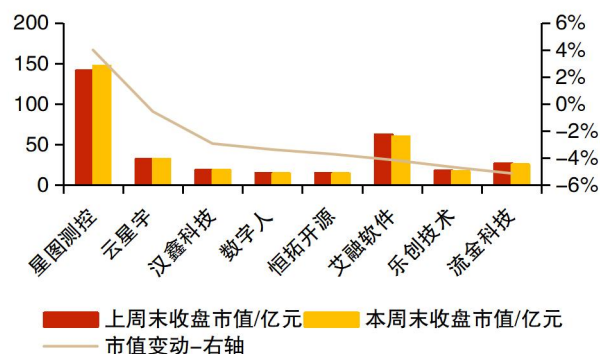
本周北交所信息技术产业企业的市值整体有所下降,总市值由 687.9 亿元降至 654.0 亿元,市值中值由 20.3 亿元降至 18.7 亿元。从分布区间来看,位于 5~10 亿元市值区间内的企业数量增加;位于 10~20 亿元市值区间内的企业数量增加;位于 20~30 亿元市值区间内的企业数量减少;位于其他市值区间内的企业数量不变。从本周个股市值表现来看,星图测控 (+4.00%)、云星宇 (-0.55%)、汉鑫科技 (-2.93%) 分列市值涨跌幅前三甲。

图表 23: 北交所信息技术产业总市值降至 654 亿元 (家)



资料来源: iFinD、华源证券研究所

图表 24: 星图测控、云星宇等市值涨跌幅居前

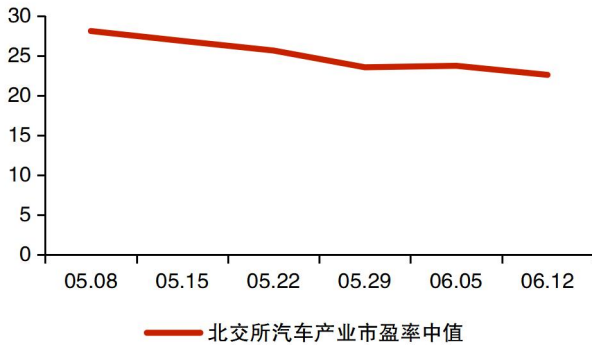


资料来源: iFinD、华源证券研究所

➤ 汽车（22家）：市盈率 TTM 中值由 23.7X 降至 22.6X

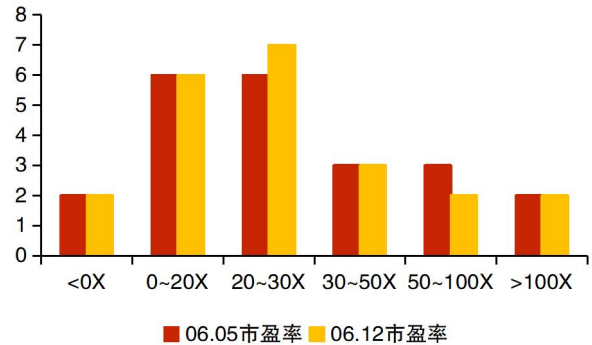
本周，从估值表现看，北交所汽车产业企业的市盈率 TTM 中值由 23.7X 降至 22.6X。从分布区间来看，位于 20~30X 区间内的企业数量增至 7 家；位于 50~100X 区间内的企业数量减至 2 家；位于其他区间内的企业数量不变。

图表 25：北交所汽车产业 PETTM 中值降至 22.6X



资料来源：iFinD、华源证券研究所

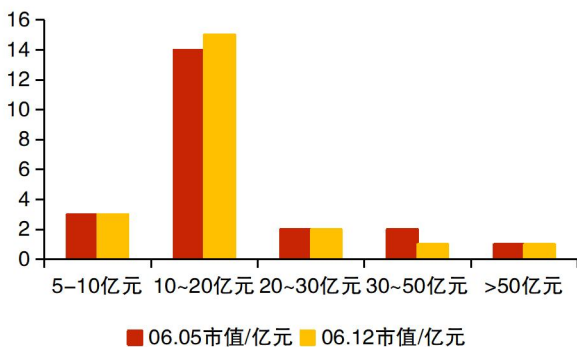
图表 26：0~20X 区间内的企业数量保持 6 家（家）



资料来源：iFinD、华源证券研究所

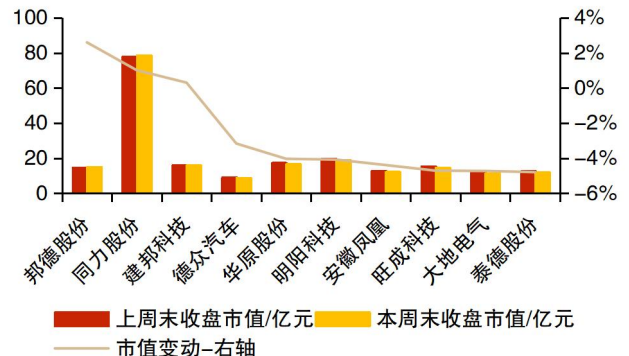
本周北交所汽车产业企业的市值整体有所下降，总市值由 431.8 亿元降至 410.2 亿元，市值中值由 14.9 亿元降至 14.6 亿元。从分布区间来看，位于 10~20 亿元市值区间内的企业数量增加；位于 30~50 亿元市值区间内的企业数量减少；位于其他市值区间内的企业数量不变。从本周个股市值表现来看，邦德股份(+2.60%)、同力股份(+1.01%)、建邦科技(+0.30%) 分列市值涨跌幅前三甲。

图表 27：北交所汽车产业总市值降至 410 亿元（家）



资料来源：iFinD、华源证券研究所

图表 28：邦德股份、同力股份等市值涨跌幅居前

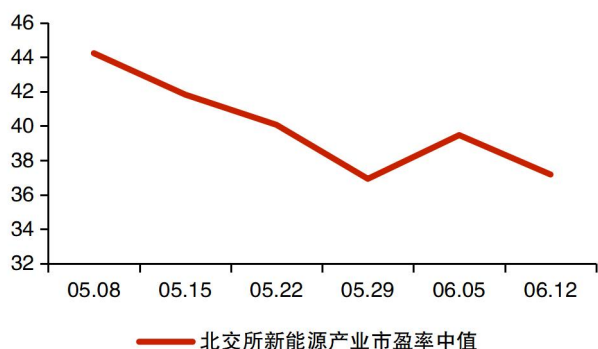


资料来源：iFinD、华源证券研究所

➤ 新能源（19家）：市盈率 TTM 中值由 39.5X 降至 37.2X

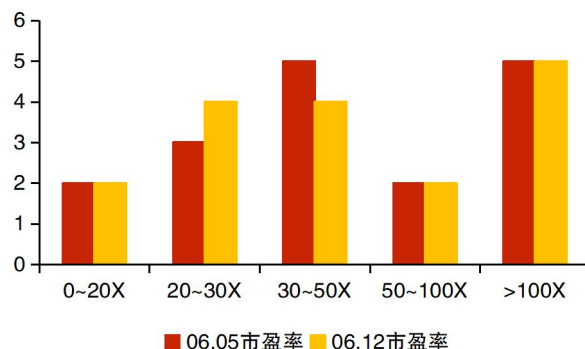
本周，从估值表现看，北交所新能源产业企业的市盈率 TTM 中值由 39.5X 降至 37.2X。从分布区间来看，位于 20~30X 区间内的企业数量增至 4 家；位于 30~50X 区间内的企业数量减至 4 家；位于其他区间内的企业数量不变。

图表 29：北交所新能源产业 PETTM 中值降至 37.2X



资料来源：iFinD、华源证券研究所

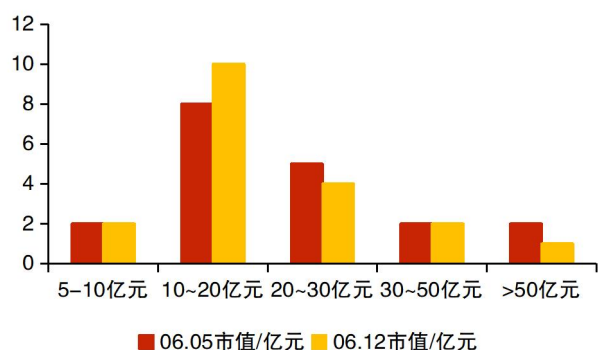
图表 30：20~30X 区间内的企业数量增至 4 家（家）



资料来源：iFinD、华源证券研究所

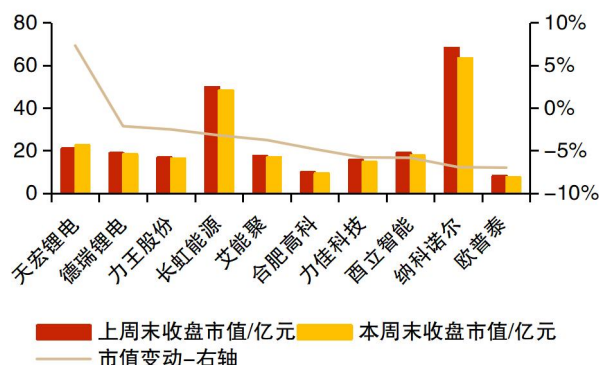
本周北交所新能源产业企业的市值整体有所下降，总市值由 473.7 亿元降至 441.4 亿元，市值中值由 19.1 亿元降至 18.1 亿元。从分布区间来看，位于 10~20 亿元市值区间内的企业数量增加；位于 20~30 亿元市值区间内的企业数量减少；位于 >50 亿元市值区间内的企业数量减少；位于其他市值区间内的企业数量不变。从本周个股市值表现来看，天宏锂电（+7.32%）、德瑞锂电（-2.14%）、力王股份（-2.52%）分列市值涨跌幅前三甲。

图表 31：北交所新能源产业总市值降至 441 亿元（家）



资料来源：iFinD、华源证券研究所

图表 32：天宏锂电、德瑞锂电等市值涨跌幅居前



资料来源：iFinD、华源证券研究所

4. 公告：骏创科技拟与合作方共同出资设立苏州巴斯巴新能源技术有限公司

卓兆点胶：基于公司经营发展需要，为进一步整合行业资源，提高公司综合竞争力，苏州卓兆点胶股份有限公司一级全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司拟以人民币 5,100.00 万元购买奥茵绅智能装备（苏州）有限公司 51% 的股权。

并行科技：为满足公司业务发展需要，公司拟向内蒙古新东吉泰科技有限责任公司采购 GPU 算力服务器，采购合同金额预计不超过人民币 2,624 万元。

骏创科技：为完善海外产能布局，开拓东南亚市场，满足海外市场配套需求，公司拟以自有资金与 XCONN DEVELOPMENT PTE. LTD. 共同出资 300.00 万美元在泰国设立子公司 XCONN Energy Technologies (THAILAND) Co., Ltd.。拟新设公司注册资本 500.00 万泰铢，公司持股比例为 1%，新加坡子公司持股比例为 99%。

骏创科技：为完善公司产品结构，实现公司向母线排产品的供应链纵向延伸，提高产品附加值，提升在储能/动力电池、新能源汽车零部件领域的综合竞争力，苏州骏创汽车科技股份有限公司与上海勳坤模具科技有限公司签署了《合资协议》，拟共同出资设立合资公司苏州巴斯巴新能源技术有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准）。拟新设公司注册资本为人民币 2,000.00 万元（人民币），其中公司出资 1400.00 万元，占注册资本的 70%，拥有合资公司 70% 的股权；上海勳坤出资 600.00 万元，占注册资本的 30%，拥有合资公司 30% 的股权。

图表 33：骏创科技拟与合作方共同出资设立苏州巴斯巴新能源技术有限公司

证券代码	证券简称	公告时间	公告内容
920026.BJ	卓兆点胶	2026 年 6 月 12 日	基于公司经营发展需要，为进一步整合行业资源，提高公司综合竞争力，苏州卓兆点胶股份有限公司一级全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司拟以人民币 5,100.00 万元购买奥茵绅智能装备（苏州）有限公司 51% 的股权。
920493.BJ	并行科技	2026 年 6 月 12 日	为满足公司业务发展需要，公司拟向内蒙古新东吉泰科技有限责任公司采购 GPU 算力服务器，采购合同金额预计不超过人民币 2,624 万元。
920533.BJ	骏创科技	2026 年 6 月 9 日	为完善海外产能布局，开拓东南亚市场，满足海外市场配套需求，公司拟以自有资金与 XCONN DEVELOPMENT PTE. LTD. 共同出资 300.00 万美元在泰国设立子公司 XCONN Energy Technologies (THAILAND) Co., Ltd.。拟新设公司注册资本 500.00 万泰铢，公司持股比例为 1%，新加坡子公司持股比例为 99%。
920533.BJ	骏创科技	2026 年 6 月 9 日	为完善公司产品结构，实现公司向母线排产品的供应链纵向延伸，提高产品附加值，提升在储能/动力电池、新能源汽车零部件领域的综合竞争力，苏州骏创汽车科技股份有限公司与上海勳坤模具科技有限公司签署了《合资协议》，拟共同出资设立合资公司苏州巴斯巴新能源技术有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准）。拟新设公司注册资本为人民币 2,000.00 万元（人民币），其中公司出资 1400.00 万元，占注册资本的 70%，拥有合资公司 70% 的股权；上海勳坤出资 600.00 万元，占注册资本的 30%，拥有合资公司 30% 的股权。

资料来源：Wind、华源证券研究所

5. 风险提示

宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、资料统计误差风险

证券分析师声明

本报告署名分析师在此声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本报告表述的所有观点均准确反映了本人对标的证券和公司的个人看法。本人以勤勉的职业态度，专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观的出具此报告，本人所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将会与本报告中的具体投资意见或观点有直接或间接联系。

一般声明

华源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告是机密文件，仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司客户。本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测等只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特殊需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的意见、评估及推测仅反映本公司于发布本报告当日的观点和判断，在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及推测不一致的报告。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。本公司不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式修改、复制或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华源证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司销售人员、交易人员以及其他专业人员可能会依据不同的假设和标准，采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点，本公司没有就此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

信息披露声明

在法律许可的情况下，本公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司将会在知晓范围内依法合规的履行信息披露义务。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级说明

证券的投资评级：以报告日后的6个月内，证券相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入：相对同期市场基准指数涨跌幅在20%以上；

增持：相对同期市场基准指数涨跌幅在5%~20%之间；

中性：相对同期市场基准指数涨跌幅在-5%~+5%之间；

减持：相对同期市场基准指数涨跌幅低于-5%及以下。

无：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

行业的投资评级：以报告日后的6个月内，行业股票指数相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好：行业股票指数超越同期市场基准指数；

中性：行业股票指数与同期市场基准指数基本持平；

看淡：行业股票指数弱于同期市场基准指数。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；

投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

本报告采用的基准指数：A股市场（北交所除外）基准为沪深300指数，北交所市场基准为北证50指数，香港市场基准为恒生中国企业指数（HSCEI），美国市场基准为标普500指数或者纳斯达克指数，新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）。